

Transfer Molding System

Model YPM1080-EP



**Transfer molding system applicable for
exposed die molding and varying package thickness**

チップ露出・パッケージ厚み可変に対応した トランスファモールド装置

製品情報



日本語

- 独自の金型駆動システムにより、高品質なチップ露出成形を実現
- パッケージ厚み・基板厚み可変に対応し、1台でさまざまな品種に対応可能
- MUF成形に最適な構造を採用
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
モデル		—	YPM1080-EP			
ワークタイプ		—	基板			
ワークサイズ	長さ	mm	150—241			
	幅	mm	60—95			
樹脂	径	mm	φ 14, 16			
	長さ	mm	15.4—35.0			
マシンタイム		sec	Approximately 40 (45*)			
外形寸法	プレス数	module	1	2	3	4
	幅	mm	2,540	3,220	3,900	4,580
	奥行き	mm	2,000	2,000	2,000	2,000
	高さ	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
重量		ton	6.5 (6.6*)	10.1 (10.3*)	13.7 (14.0*)	17.3 (17.7*)
成形取り数		workpiece	2	4	6	8
インพุットマガジンスペース		mm	440			
アウトプットマガジンスペース（スリットマガジン仕様）		mm	440			
クランプ出力		kN/(tf)	49.0—784.0/5.0—80.0			
トランスファ出力		kN/(tf)	3.92—49.0/0.4—5.0（2圧設定）			
品種切替え方式		—	キット交換式			
搭載可能金型		—	YPM1080-EP 専用金型			
リリースフィルム幅		mm	100—300			

・上記数値は当社標準機の場合です。
・改良のため仕様を変更する事があります。
・特殊システム仕様についてはご相談ください。
・*の値はリリースフィルム仕様の場合です。



本社

〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.

台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.

韓国
TOWA Korea Co., Ltd.

シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

ドイツ
TOWA Europe GmbH

オランダ
TOWA Europe B.V.

アメリカ
TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ